



POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Digi International présentera plusieurs produits nouvelle génération, dont le nouveau Digi XBee3, à Embedded World 2018

Digi va proposer des nouveaux produits de pointe et des démonstrations ancrées dans le réel lors du principal salon du domaine de l'IoT

MUNICH, 12 février 2018 – Digi International®, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services essentiels de connectivité IoT, a annoncé aujourd'hui qu'il mettrait en avant sa nouvelle gamme Digi® XBee3™ de modules et modems IoT de périphérie intelligents, et qu'il présenterait son Digi ConnectCore® 8X en avant-première lors du salon [Embedded World 2018](#). En outre, Digi organisera des démonstrations et des entretiens qui illustreront les dernières avancées en matière de technologies et de produits intégrés. Embedded World se déroulera du 27 février au 1^{er} mars 2018 au Parc des Expositions de Nuremberg. Digi exposera ses solutions dans le Hall 3, stand 518.

Les modules RF nouvelle génération de la gamme Digi XBee3 sont montés sur un micro facteur de forme d'une taille minuscule et sont conçus pour supporter les innovations en matière d'IoT en périphérie de réseau. Offrant une approche modulaire de la connectivité IoT, le Digi XBee3 propose également une programmabilité MicroPython et des radios bimodes, ainsi que la possibilité de passer, par le biais d'un logiciel, au Bluetooth à basse consommation (*Bluetooth LE*), permettant ainsi une souplesse de conception sans-fil, une intégration économique et un ajout de fonctionnalités facilité. On obtient ainsi des solutions IoT innovantes pouvant être développées, prototypées et fabriquées en série plus rapidement.

Digi va présenter ses ordinateurs monocartes et son System-on-Modules (SOM) Digi ConnectCore 8X en avant-première. Digi est l'un des partenaires en accès anticipé de NXP et le minuscule module exploitera la famille de processeurs NXP i.MX 8X basée sur les cœurs ARM® Cortex®-A35 et Cortex-M4F. La disponibilité du kit de développement est actuellement prévue pour le 3^{ème} trimestre de 2018.

« Embedded World est le lieu idéal pour présenter ces produits de pointe aux professionnels de l'ensemble de l'industrie de l'IoT », a déclaré Mike Ueland, vice-président directeur de Digi International. « Avec Digi XBee3, nous proposons un module pouvant offrir l'intelligence et la souplesse nécessaires à l'alimentation de la nouvelle génération

d'applications IoT et nous sommes ravis de pouvoir faire une démonstration de ses capacités, ainsi que de celles de nos autres solutions, au cours de cet événement mondial de premier plan. »

Présentations et démonstrations de produits

- **Gamme Digi XBee3** – Les capacités de la toute nouvelle gamme Digi XBee3 de modules et modems IoT de périphérie intelligents seront présentées sur le stand de Digi ainsi que sur celui de certains partenaires. Le micro facteur de forme du Digi XBee3 fait un tiers de la taille du module Digi XBee RF original et, ne mesurant que 13 mm x 19 mm, il est l'un des plus petits modules programmables MicroPython de l'industrie capables d'offrir une connectivité RF pour les applications de courte portée et de liaison sans-fil à faible consommation d'énergie (LPWAN). La gamme Digi XBee3 est également disponible pour les facteurs de forme à trou traversant et à montage en surface Digi XBee existants. Grâce à sa consommation, ses dimensions et son poids réduits, le Digi XBee3 est parfaitement adapté aux applications compactes et alimentées par batterie, et il offre plusieurs niveaux de programmabilité, la possibilité de fournir des renseignements en périphérie de réseau ainsi que la possibilité de basculer entre différents protocoles sans modifier l'appareil.
- **Présentation en avant-première du Digi ConnectCore 8X** – Digi présentera les ordinateurs monocartes et les System-on-Modules Digi ConnectCore 8X System-on-Modules en avant-première sur son stand. Exploitant le facteur de forme Digi SMTplus™ (brevet déposé), ce minuscule module est monté sur la nouvelle famille de processeurs NXP i.MX 8X, basée sur les cœurs ARM® Cortex®-A35 et Cortex-M4F, et il offre une connectivité 802.11ac + Bluetooth Smart, un traitement des vidéos, des images et graphique, des capacités audio/vocales, ainsi que la sécurité Digi TrustFence® pour les applications IoT avancées des secteurs de la santé/médical, industriel, du transport, de l'immobilier et de l'IHM avancée, entre autres. Tirant profit de l'expertise unique de Digi dans le domaine de l'IoT, il offrira un concept de solutions pour système connecté révolutionnaire pour les fabricants d'appareils produisant des produits intelligents en périphérie. Digi a été choisi comme partenaire en accès anticipé par NXP.
- **Démonstration CVC du Digi XBee3 Cellular** – Cette démonstration montrera comment la capacité de programmation intégrée du modem Digi XBee3 Cellular permet à celui-ci de servir de dispositif périphérique intelligent ainsi que de modem sans-fil. La démonstration CVC montrera comment le Digi XBee3 Cellular joue le rôle d'interface sans-fil et de régulateur thermique local. Elle mettra également l'accent sur trois aspects technologiques clés qui sont essentiels à toute application IoT utilisant l'intelligence en périphérie : une intelligence en périphérie au sein du module sans-fil, une commande autonome en périphérie, et une intégration facile avec les interfaces dans le cloud tierces.

- **Démonstration du Centre d'intervention médicale de secours en cas de catastrophe naturelle** – Cette démonstration aura recours aux produits Digi ConnectCore 6, Digi ConnectCore 6UL et Digi XBee3 Cellular pour simuler un système offrant aux hôpitaux de campagne et d'urgence la possibilité de surveiller les signes vitaux des patients en continu et d'alerter les équipes d'intervention rapide si nécessaire. Cela aide à éliminer les incidents d'échec de secours, permet un suivi centralisé de plusieurs sites et patients, et permet le regroupement et l'analyse des données des sites locaux, régionaux et mondiaux afin d'analyser les caractéristiques, tendances et résultats. La démonstration se compose de trois parties : un nœud patient intelligent qui contrôle les signes vitaux tels que la température, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire ; une passerelle hospitalière intelligente qui reçoit, traite et transmet les données des nœuds vers le cloud et l'EWS tout en exécutant une interface utilisateur à affichage local ; et une application dans le cloud, qui reçoit, stocke dans une base de données et traite les données des capteurs, les EWS et les états d'alarme, et qui met les données disponibles à disposition des intervenants avant qu'ils arrivent au chevet du patient.

Réunions d'information

- Le mardi 27 février, de 9 h 30 à 10 h, Mike Rohmoser, directeur principal du marketing des produits de Digi International, fera une présentation dans le cadre de la réunion 6647 intitulée « Choisir la technologie cellulaire de liaison sans-fil à faible consommation d'énergie pour l'IoT » (*Selecting Cellular LPWAN Technology for the IoT*). La réunion examinera les options disponibles lors du choix du réseau cellulaire convenant à vos applications et appareils IoT avec l'adoption de nouvelles normes pour le LTE.
- Le mercredi 28 février, de 16 h à 16 h 30, Alex Gonzales, directeur en génie logiciel de Digi, présentera « Le Projet Yocto de Linux comme plateforme pour la conception de systèmes intégrés » (*Yocto Project Linux as a Platform for Embedded Systems Design*) dans le cadre de la réunion 6632, afin d'analyser la raison pour laquelle le Projet Yocto pourrait être utilisé à la place de distributions binaires non-intégrées traditionnelles, telles que Debian ou Ubuntu.
- Le jeudi 1^{er} mars, à 13 h, Digi tiendra une réunion intitulée « Quelles sont les attributs nécessaires des appareils IoT intelligents ? » (*What Are The Necessary Attributes Of Smart IoT Devices?*) qui définira les principaux éléments d'un nœud d'extrémité intelligent. La présentation et la discussion auront lieu sur le stand du partenaire de Digi, Mouser (Hall 3, stand 610).

Co-exposants et participation des partenaires

Outre son propre stand, Digi présentera des solutions sur l'ensemble du site en compagnie de ses partenaires, notamment Digi-Key Electronics (Hall 4A, stand 633), Mouser (Hall 3, stand 610), CODICO (Hall 3, stand 310), Atlantik Elektronik (Hall 3, stand 141), NXP Semiconductors (Hall 4A, stand 220) et Silicon Labs (Hall 4A, stand 128).

- **Démonstrations sur stand**

- ConnectCore pour i.MX6UL – La démonstration interactive présentera les principales caractéristiques du robuste SOM ConnectCore pour i.MX6UL, qui inclut la sécurité Digi TrustFence®, le fonctionnement à très faible consommation d'énergie, l'intégration de capteurs, la connectivité au cloud, l'intégration du dispositif d'affichage et des capacités d'interface utilisateur.
- Démonstration produit du Digi XBee3 Cellular – Cette démonstration montrera la façon dont la capacité de programmation intégrée du modem Digi XBee3 Cellular lui permet de servir de dispositif périphérique intelligent ainsi que de modem sans-fil. La démonstration CVC montrera comment le Digi XBee3 Cellular joue le rôle d'interface sans-fil et de régulateur thermique local.
- Digi XBee3 Cellular CVC – Cette démonstration interactive effectuée en compagnie du partenaire de Digi, Silicon Labs, illustrera la connectivité sécurisée au cloud au travers de la notification par le Digi XBee3 Cellular de données de température dans la durée et depuis plusieurs endroits.

À propos de Digi International

Digi International®, (NASDAQ : DGII) est un leader mondial de produits et de services essentiels de connectivité IdO et *machine-to-machine* (M2M). Nous aidons nos clients à créer la prochaine génération de produits connectés. En outre, nous déployons et gérons des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants avec des niveaux de sécurité élevés, une fiabilité continue et des performances à toute épreuve. Fondée en 1985, nous avons aidé nos clients à connecter plus de 100 millions d'objets et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour de plus amples informations, visitez le site internet de Digi en cliquant sur www.digi.com, ou appelez le 877-912-3444 (depuis les États-Unis) ou le +1 952-912-3444 (à l'international).

Note aux rédacteurs

Si vous souhaitez organiser une présentation des produits ou un entretien avec un cadre de Digi au cours du salon Embedded World 2018, merci de contacter Anthony Hildebrand ou John Waite, de Catalyst For Content, à l'aide des coordonnées ci-dessous.

Contacts presse :

Europe

Anthony Hildebrand ou John Waite

Catalyst For Content

Bureau : +44 (0) 1753 648140

anthony@catalystforcontent.com, john@catalystforcontent.com

Amérique du Nord

Joseph Rigoli

LEWIS

Bureau : +1 781-418-2400

Digi@teamlewis.com